

2013年3月期 第3四半期決算説明資料

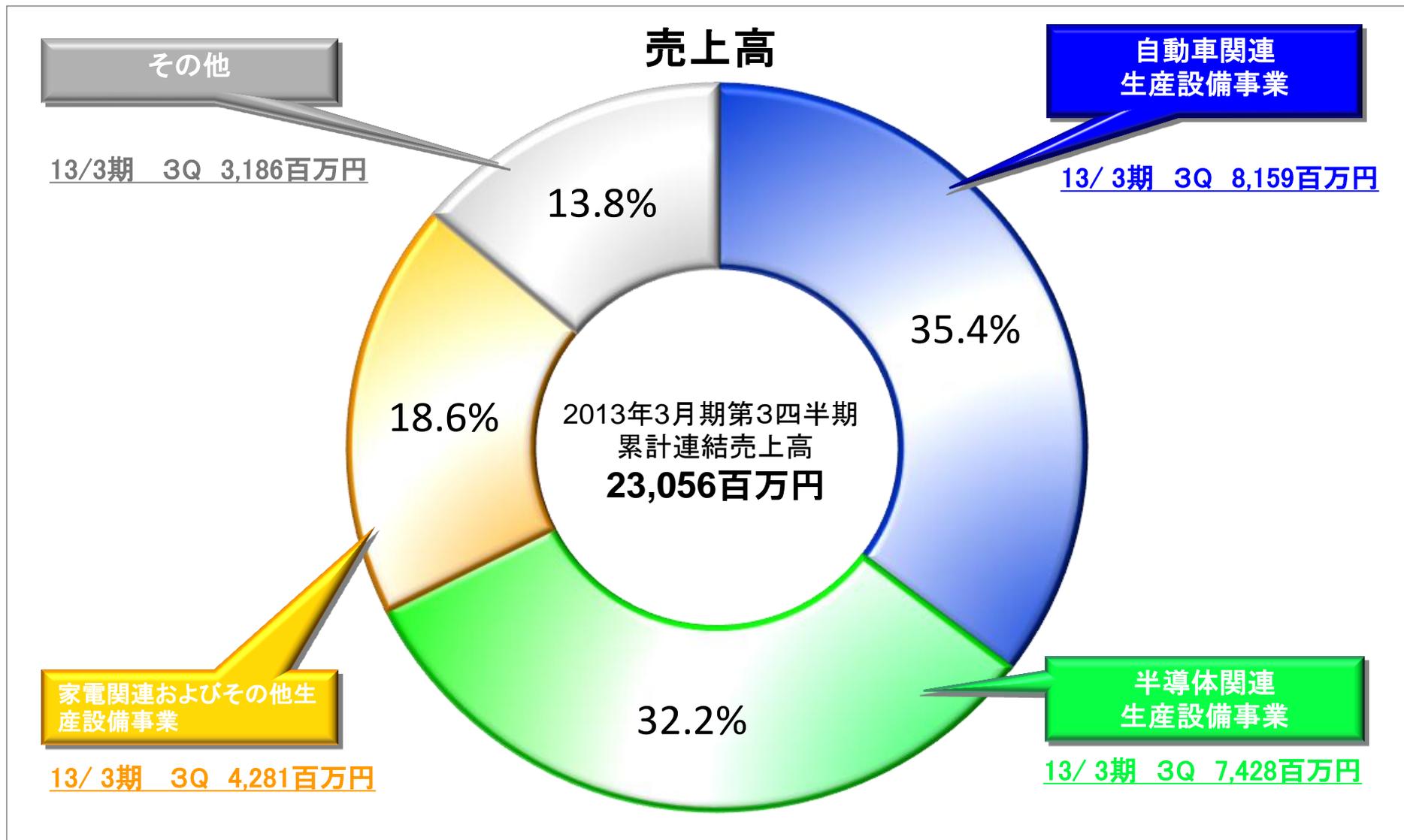
平田機工株式会社 2013. 2. 12



I 決算状況

2013年3月期第3四半期（2012年12月31日）

I 決算状況 事業部門別売上高構成比



【注】今期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

決算概要

- 売上予定案件の期ずれによる売上減により、連結売上高は前年同期比34.6%減となった。
- 売上減に加え、売上原価率の増加等により、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに赤字計上。
- 受注高も減少しているが、受注残高は増加。

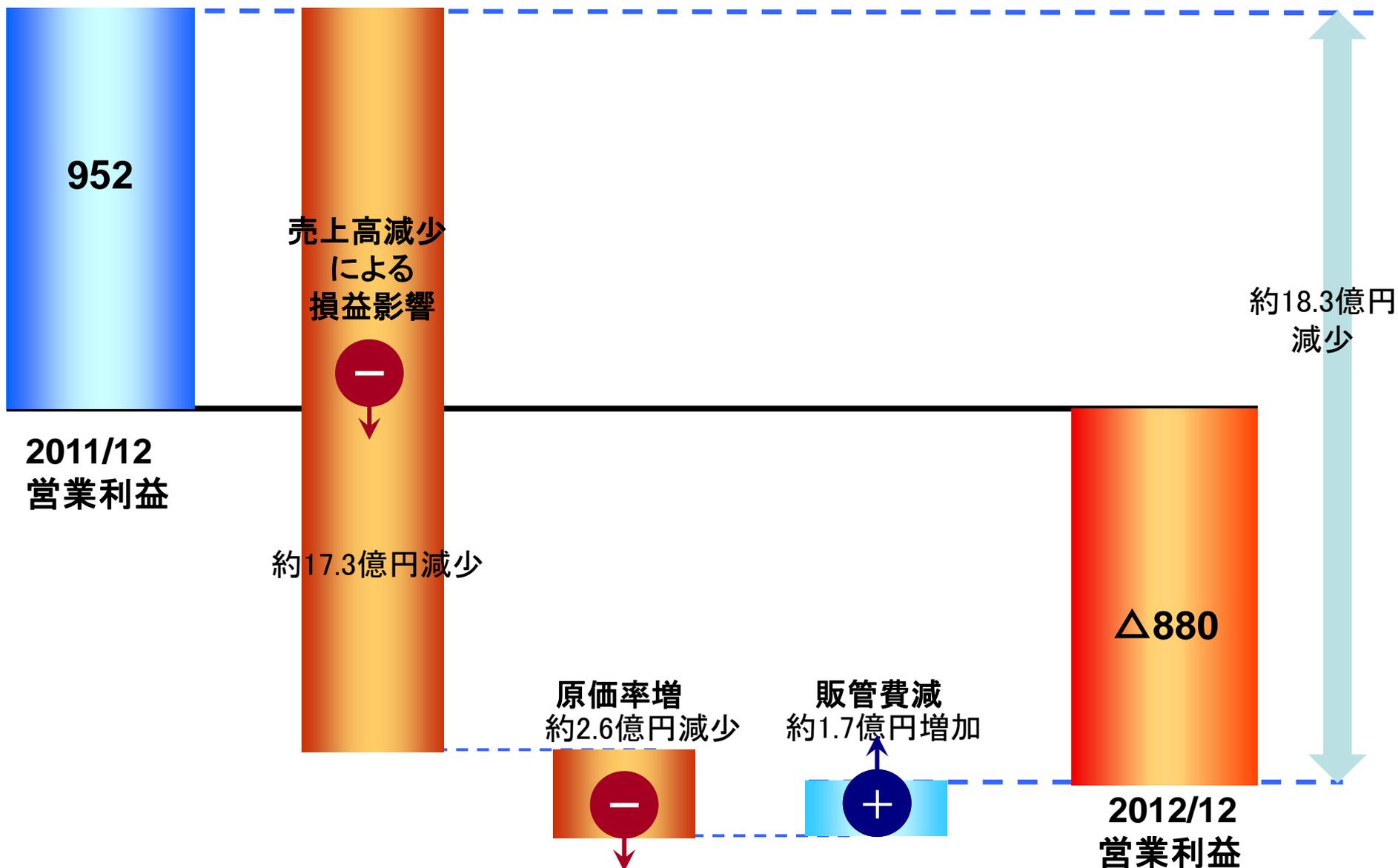
(単位:百万円)

連結決算	2012年3月期 第3四半期	2013年3月期 第3四半期	対前年同期比
売上高	35,241	23,056	△34.6%
営業利益	952	△880	—
経常利益	1,007	△975	—
四半期純利益	218	△772	—
受注高	32,686	30,467	△6.8%
受注残高	18,798	26,906	+43.1%



I 決算状況 営業利益の増減要因分析

(単位:百万円)



I 決算状況 事業部門別連結売上高

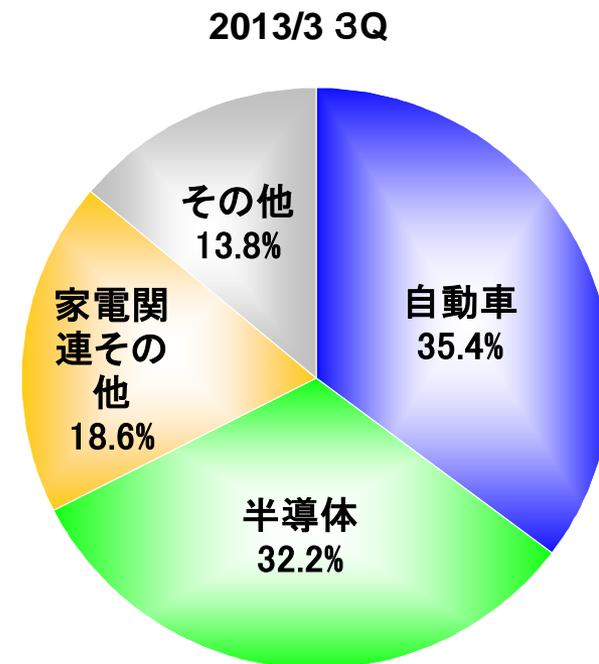
■ 売上・受注予定案件の期ずれにより、全体的に低調な水準に留まる。

- ・ 自動車関連設備: 北米メーカー向けは好調だがその他の案件の売上が減少した。
- ・ 半導体関連設備: 製造受託案件の受注の遅れなどにより低調に推移した。
- ・ 家電関連およびその他設備: 家電、タイヤ等、全体的に低調な状況が続く。

事業部門別売上高の状況

単位:百万円

事業部門	2013/3 3Q
自動車	8,159
半導体	7,428
家電関連その他	4,281
その他	3,186
合計	23,056



【注】今期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

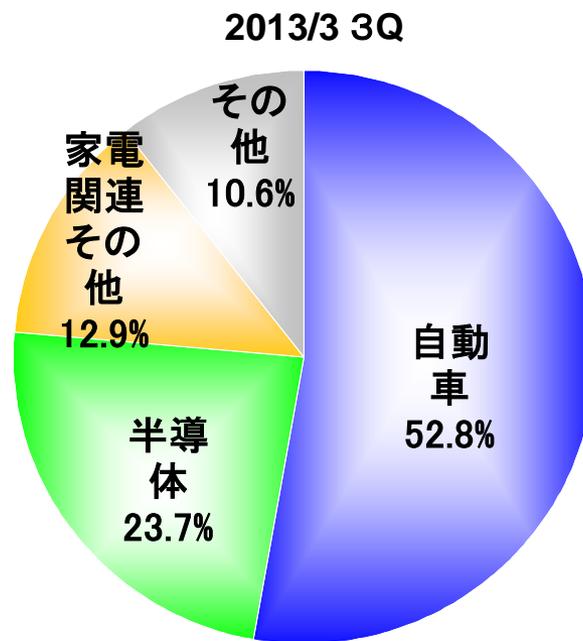
■ 半導体関連で受注が遅れているが、北米メーカーを中心に自動車関連の受注は堅調に推移。

- ・ 自動車関連設備：北米メーカーの受注が継続し、堅調に推移した。
- ・ 半導体関連設備：国内および北米メーカーからの受注が続くものの、製造受託案件の遅れにより低調。
- ・ 家電関連およびその他設備：家電、タイヤ等、全体的に低調。

事業部門別受注高の状況

単位：百万円

事業部門	2013/3 3Q
自動車	16,075
半導体	7,214
家電関連その他	3,946
その他	3,231
合計	30,467



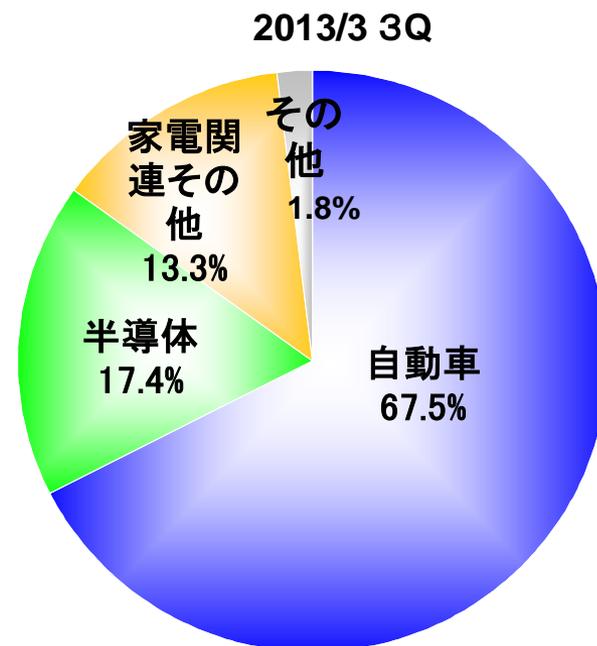
【注】今期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

- 第3四半期に自動車関連等の複数の大型案件を受注したことにより受注残が増加した。

事業部門別受注残高の状況

単位：百万円

事業部門	2013/3 3Q
自動車	18,161
半導体	4,684
家電関連その他	3,566
その他	494
合計	26,906



【注】今期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

ウェーハ真空搬送ロボットの開発・FOUPオープナの改良

当社は300 mm/450 mmウェーハに兼用できるウェーハ真空搬送ロボットを開発しました。また同製品は改良型450mmウェーハ対応FOUPオープナとともにSEMICON Japan 2012に出展しました。

300 mm/450 mmのウェーハに兼用できるウェーハ真空搬送ロボット AR-Wn シリーズ
高真空に対応できる本製品は、ダイレクトドライブモーターの搭載により、高精度、高速動作、高信頼を実現し、アームバリエーションも豊富でお客様の生産効率向上に貢献します。

● 製品の特長

- (1) 高精度 振動を約70～85%低減
- (2) 高速動作 スループット約30%アップ
- (3) 高信頼 各種トラブル回避対策
- (4) 豊富なアームバリエーション
- (5) メンテナンス性の向上
- (6) 真空プラットフォームの提供



300mm/450mmウェーハ
対応真空搬送ロボット
AR-Wn シリーズ

450mmウェーハ対応FOUPオープナ KWFシリーズ

● 製品の特長

- (1) 低価格の実現
- (2) 多彩な容器に対応
- (3) 豊富なバリエーション
- (4) 実績多数の高信頼



450mmウェーハ対応
FOUPオープナ
KWFシリーズ

これらの製品は2014年3月期以降の業績に寄与すると見込んでいます。

Ⅲ 2013年3月期業績の見通し

2013年3月期第3四半期（2012年12月31日）

年明け後、欧州の信用不安後退、米国の景気動向指数の改善などから世界経済の下ぶれリスクは低下し、国内景気も為替相場の円安傾向等を背景に回復の予兆が見られるが、依然、不透明感強い。但し、国内外ともに自動車関連については設備投資の拡大が期待できる状況である。

自動車関連事業

当社が主要な取引先とする北米自動車メーカーは、北米市場、中国市場を中心に販売台数が増加しており、今後も好調に推移する見込み。尚、国内メーカーも海外市場を中心に好調だが、中国市場では関係悪化の影響が続く見込みである。

半導体関連事業

日米双方の市場ともに受注回復の期待が高まっているが、パソコンの需要低迷が続く中、スマートフォンの成長も鈍化が懸念されており、本格回復に至るか否か不明確な状況が続く。

家電関連およびその他

家電関連は国内では低迷が続き、メーカー各社は次世代商品を模索している状況であり、急激な市況回復は見込めない状況。タイヤについても中国市場での日本車の販売不振等により不透明感が強い。

Ⅲ 2013年3月期業績の見通し 業績予想

※通期業績予想、下期業績予想を修正いたしております。

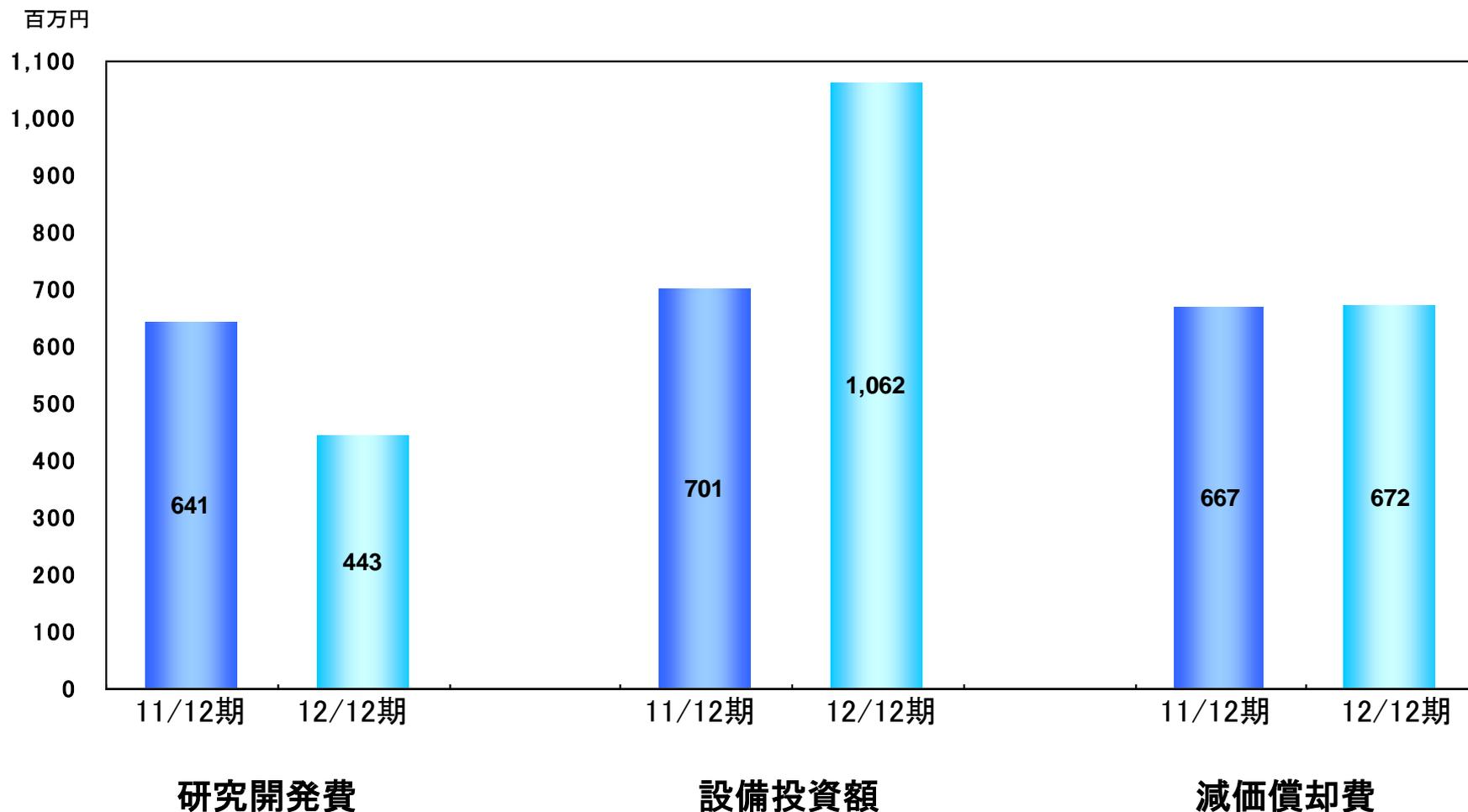
(単位:百万円)

	上期	下期	通期
売上高	16,496	22,504	39,000
自動車関連	5,876	9,623	15,500
半導体関連	5,405	7,094	12,500
家電関連およびその他	2,936	4,063	7,000
その他	2,277	1,722	4,000
営業利益(率)	△444(一)	594(2.6%)	150(0.4%)
経常利益(率)	△485(一)	535(2.4%)	50(0.1%)
当期(四半期)純利益(率)	△354(一)	414(1.8%)	60(0.2%)

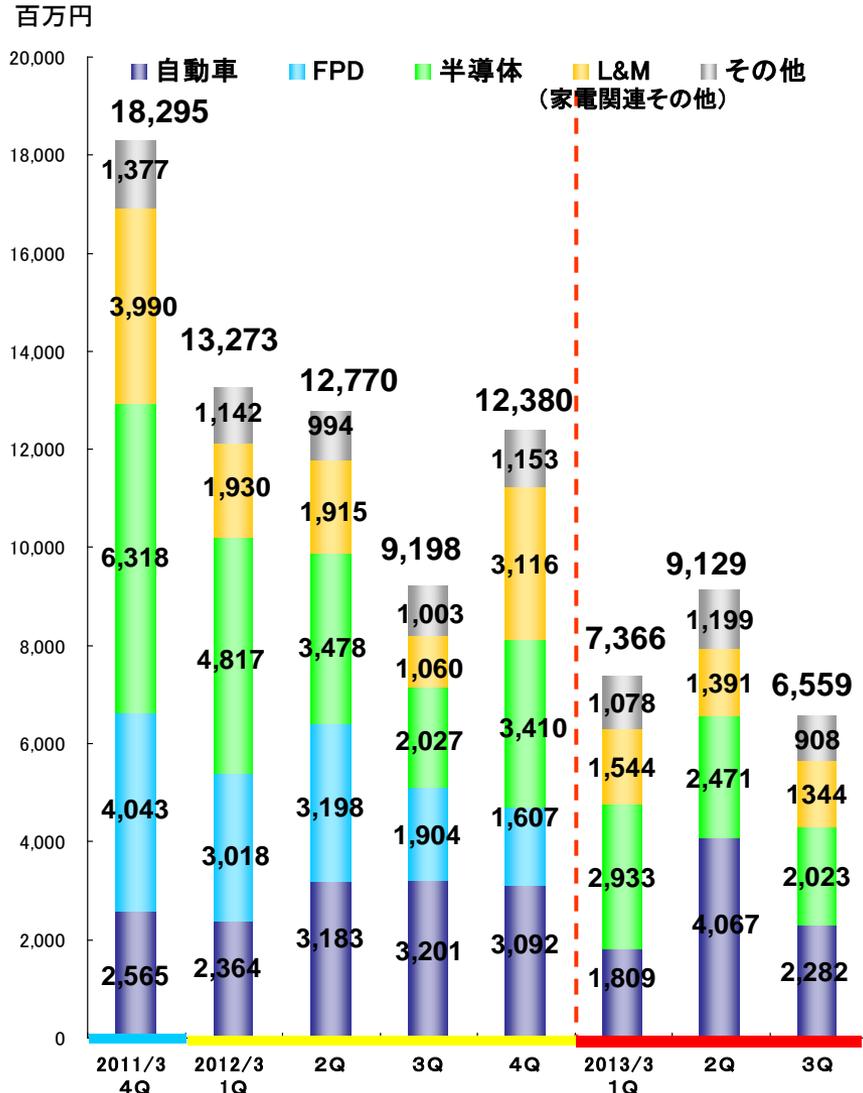
【注】FPD関連事業の売上減少により、今期予想からFPD関連事業は半導体関連事業に含めております。

IV 参考資料

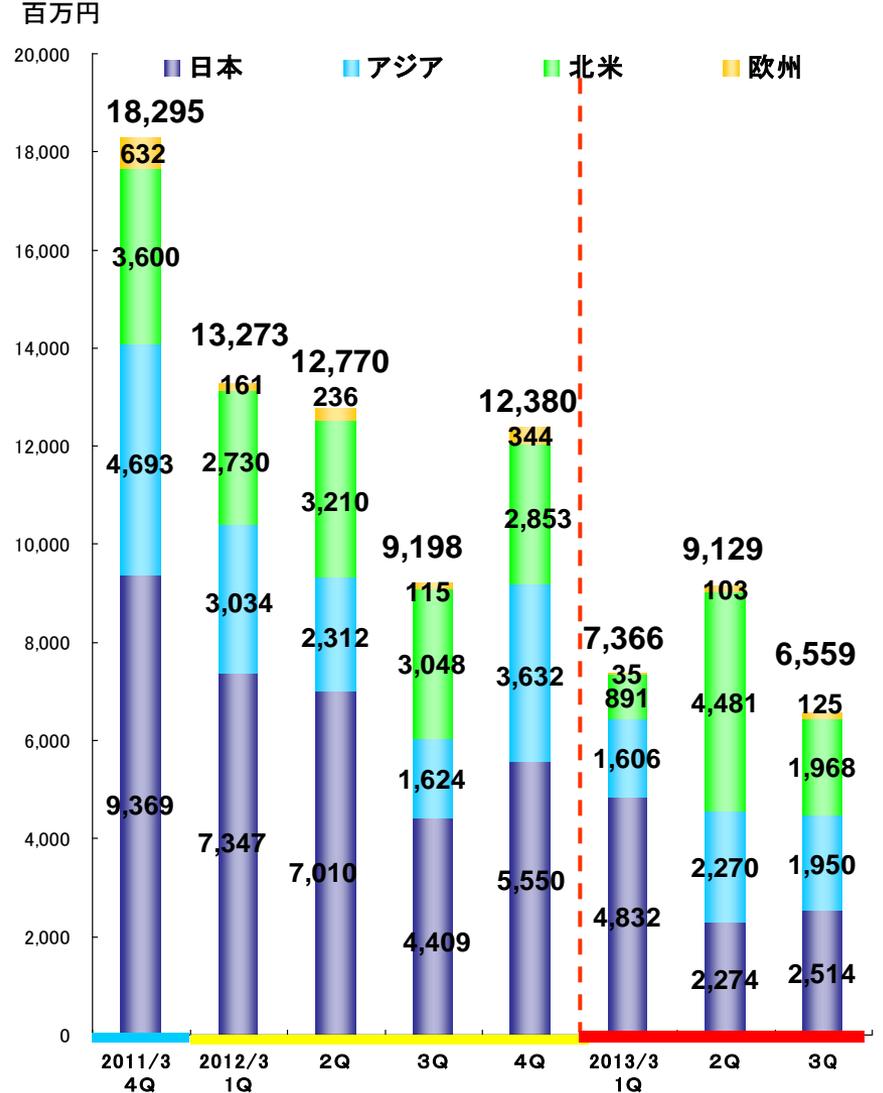
2013年3月期第3四半期（2012年12月31日）



事業部門別四半期売上高の推移

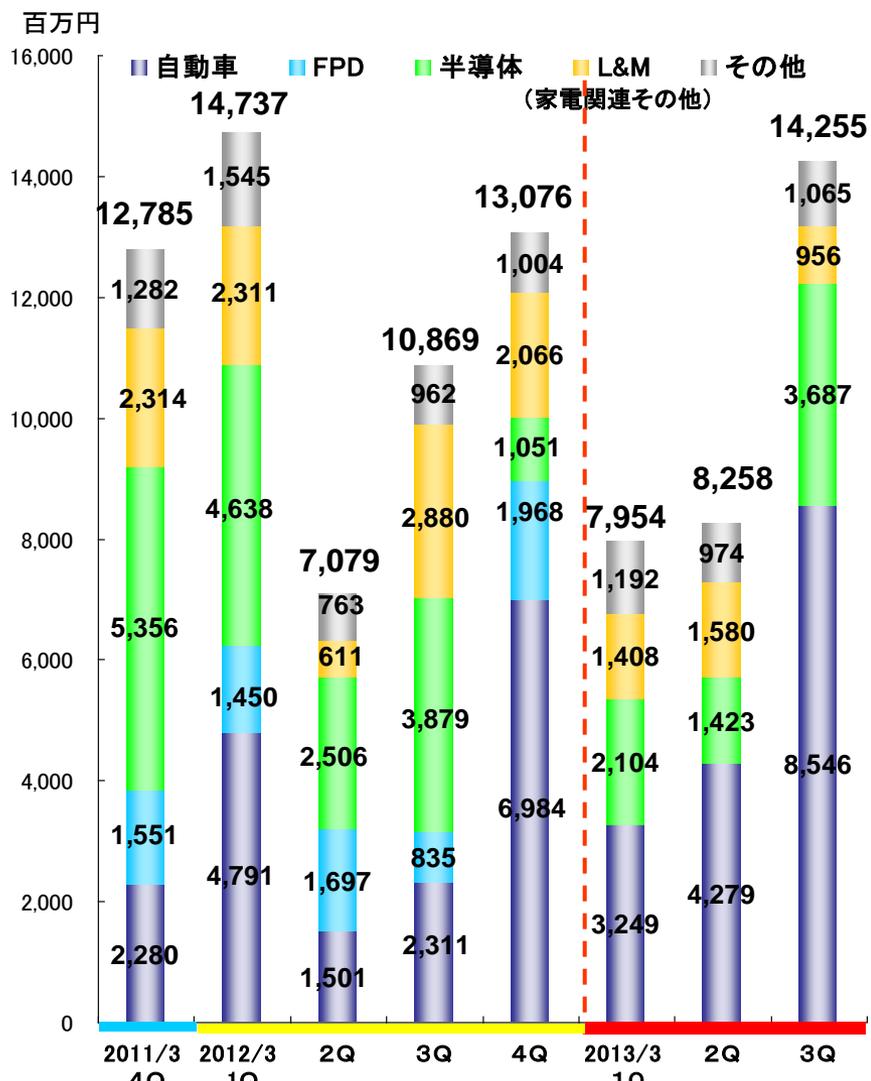


地域別四半期売上高の推移

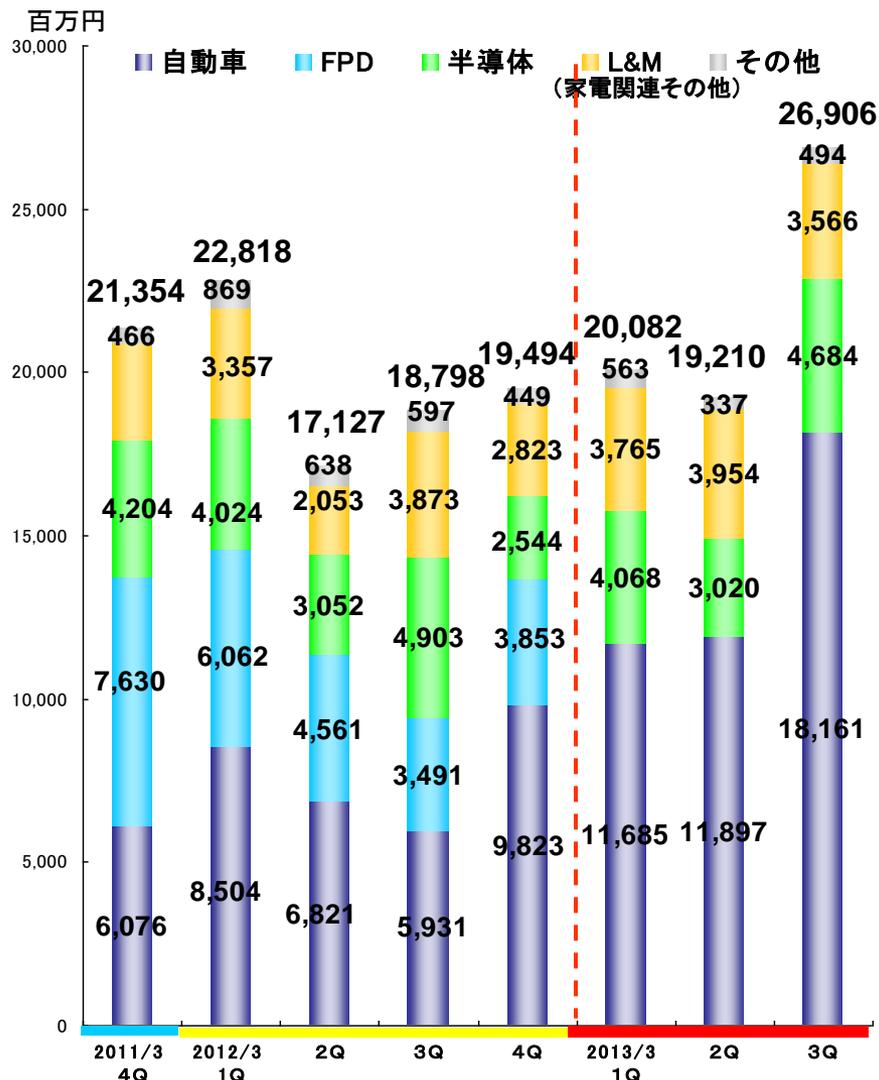


【注】2013年3月期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

事業部門別四半期受注高の推移



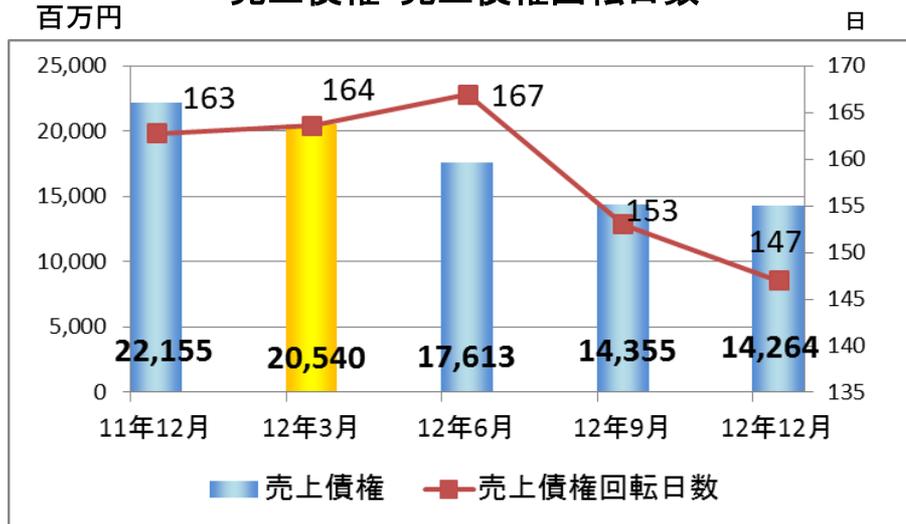
事業部門別四半期受注残高の推移



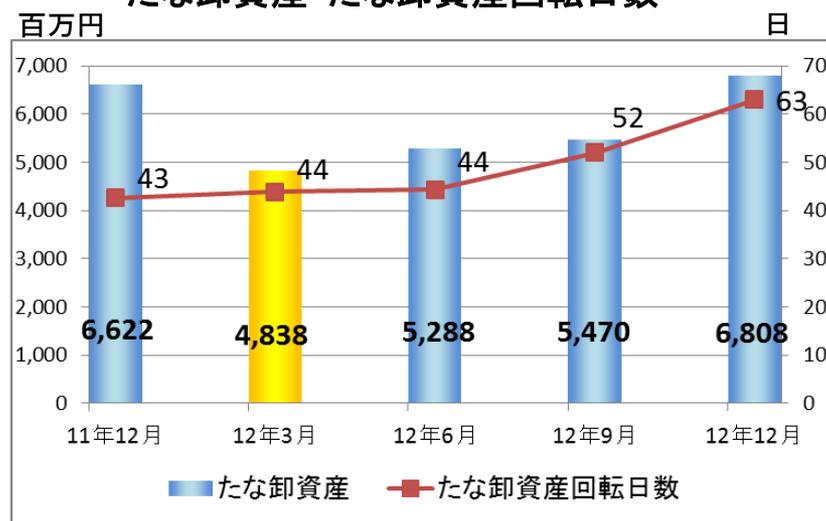
【注】2013年3月期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

IV 参考資料 主要指標

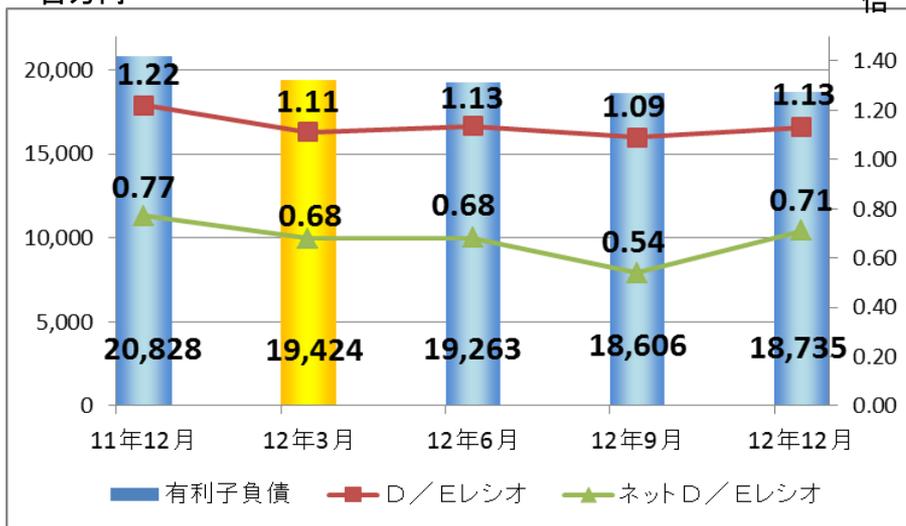
売上債権・売上債権回転日数



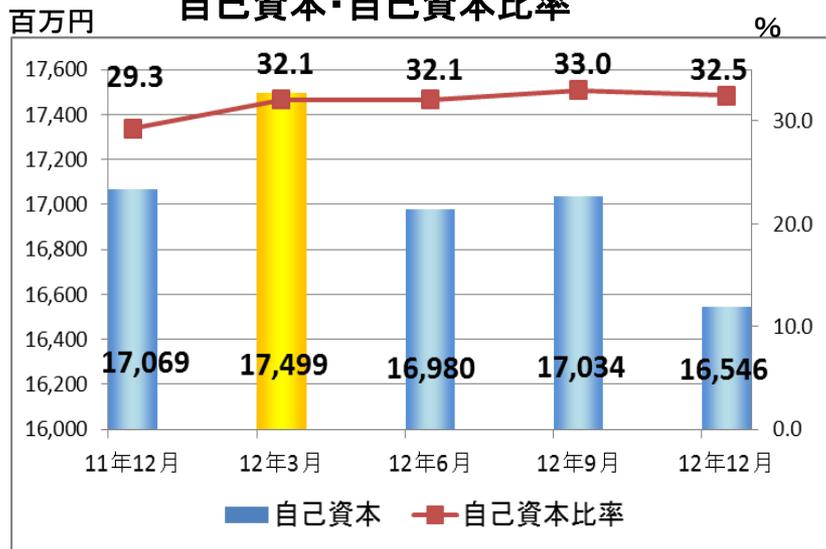
たな卸資産・たな卸資産回転日数



有利子負債残高・D/Eレシオ・Net D/Eレシオ



自己資本・自己資本比率



【注】売上債権回転日数、たな卸資産回転日数については、各四半期毎の期中平均値にて算出しております。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることあることをご承知おきください。